



DualPack3 : la densité de puissance simplifiée

Des performances aux coûts optimisés dans un boîtier standard

Les nouveaux modules DualPack3 dotés de la technologie IGBT7 offrent une densité de puissance, une optimisation des coûts et des performances robustes dans un boîtier compact et éprouvé. Disponible avec des courants nominaux de 300 à 900 A, à 1200 V et 1700 V, le DualPack3 est spécialement conçu pour les applications exigeantes actuelles.

Principales caractéristiques

- Densité de puissance élevée dans une empreinte réduite
- Jusqu'à 20 % de pertes en moins par rapport à IGBT4
- Boîtier compact 152 x 62 x 20 mm
- Sortie de courant plus élevée sans mise en parallèle de modules
- Pilotage de grille simplifié avec contrôle précis de l'échelon dV/dt
- Fonctionnement fiable jusqu'à une température de surcharge de 175 °C
- Chaîne d'approvisionnement sécurisée grâce à la prise en charge multi-fournisseurs

Découvrez tous les avantages que le DualPack3 peut apporter à votre prochain système.



microchip.com/DualPack3



Le nom et le logo de Microchip ainsi que le logo Microchip sont des marques déposées de Microchip Technology Incorporated aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.
© 2026 Microchip Technology Inc. Tous droits réservés.
MEC2632A-FRE-04-26